

中国电子学会 集成电路产教融合发展联盟

学会总〔2021〕17号

关于组织推荐 2020 中国电子学会集成电路 奖学金候选人的通知

各有关单位：

为进一步夯实我国集成电路产业人才基础，引导和鼓励更多青年学生投身集成电路事业发展，在中国电子学会、集成电路产教融合发展联盟的共同倡议下，在上海壁仞智能科技有限公司、北京理工大学教育基金会的支持下，设立“中国电子学会集成电路奖学金”（下称奖学金），用于向在读期间取得优秀成果的在校本科生、研究生发放奖学金。有关事项通知如下。

一、总体安排

奖学金每学年评选一次，分一等和特等两个等级。另设“壁仞专项奖学金”。

具备学位授予权，并且设立集成电路或相关专业的高等学校或科研机构，具有推荐资格。

二、奖学金额度

1. 特等奖学金每人 5 万元，本期不超过 5 人。
2. 一等奖学金每人 1.2 万元，本期不超过 55 人。
3. 壁仞专项奖学金 1 万元，本期不超过 3 人。专项奖学金额度可以叠加获得。获得奖学金的学生可获得壁仞公司提供的实习机会。实习时间需持续三个月以上，自奖学金评选结果公布之日起一年内完成；实习期间除享受公司实习补贴外，实习结束后可获得额外 1 万元（税前）补助。

三、名额分配

1. 教育部等支持建设示范性微电子学院的学校，分配 2 个一等奖学金直推名额和 1 个一等奖学金候选人推荐名额；支持筹备建设示范性微电子学院的学校，分配 1 个一等奖学金直推名额和 1 个一等奖学金候选人推荐名额。

2. 其他设立集成电路或相关专业的高等学校或科研机构，每个单位分配 1 个一等奖学金候选人推荐名额。

3. 特等奖学金在获评一等奖学金的人选中评选产生。奖学金等级唯一、奖金不叠加。

四、基本申请条件及要求

全日制普通本科二年级及以上的在校生以及在读研究生，符合以下条件：

- （一）热爱社会主义祖国，拥护中国共产党的领导。
- （二）遵守宪法和法律，遵守学校规章制度。

(三) 诚实守信，道德品质优秀。

(四) 在校期间学习成绩优秀，社会实践、创新能力、综合素质等方面表现突出。

(五) 当年已获得或正在申报国家级奖学金的学生，不得重复推荐。

(六) 以学校、科研院所为单位统一推荐，不接受超额推荐和个人自荐。不接受同一单位多渠道申请。

(七) 专业范围

1. 集成电路科学
2. 集成电路制造工艺
3. 集成电路设计与 EDA 技术
4. 微纳集成系统
5. 集成电路封装与测试
6. 集成电路材料与装备

壁仞专项奖学金：人工智能芯片相关的硬件设计、系统架构及软件和算法等。

五、结果发布与奖学金发放

评审结果在 2021 年 5 月发布，表彰仪式将择机举行，同期开展交流活动。

奖学金原则上在上半年发放至学生个人账户。

六、材料报送及要求

申报人的主要成果、事迹和所获荣誉等，应为 2020 年 8 月 31 日以前获得，语言表述应严谨、准确，涉及数字的准确到个位数。推荐材料不涉及国家秘密。

（一）在线填报方式

推荐单位推荐时需向学会提交“中国电子学会集成电路奖学金”系统用户申请表（见附件）。获得账号后，登录中国电子学会科技评价服务系统（<http://etst.cie.org.cn>），点击“集成电路奖学金”模块在线填写。

系统开放时间自通知发布之日起至2021年3月21日止。请按照填写说明在系统开放时间内填报。

（二）纸质材料

纸质版推荐材料包括主件和附件。纸质版主件应从系统中生成并打印（包含“中国电子学会”水印），附件直接提供，保证与系统上传文件一致。主件和附件应合订，单双面不限，签字盖章后将原件1套报送中国电子学会。

报送纸质材料的截止时间为2021年3月26日，逾期不予受理。

七、联系方式

联系人：荆博 孙志玲

联系电话：010-68600699 68600695

联系邮箱：cstat@cie-info.org.cn

联系地址：北京市海淀区玉渊潭南路普惠南里13号楼

附件：2020中国电子学会集成电路奖学金推荐系统用户申请表

(此页无正文)



主题词：集成电路 奖学金 通知

主送：高等院校、科研院所

抄送：工业和信息化部、教育部

中国电子学会

2020年2月3日印发
